

2022-2028年中国半导体设备市场发展态势与投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2022-2028年中国半导体设备市场发展态势与投资战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/U72719D7ZG.html>

报告价格：印刷版：RMB 8000 电子版：RMB 8000 印刷版+电子版：RMB 8200

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

智研数据研究中心发布的《2022-2028年中国半导体设备市场发展态势与投资战略咨询报告》共十四章。首先介绍了半导体设备行业市场发展环境、半导体设备整体运行态势等，接着分析了半导体设备行业市场运行的现状，然后介绍了半导体设备市场竞争格局。随后，报告对半导体设备做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体设备行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体设备产业有个系统的了解或者想投资半导体设备行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体设备行业基本概述

1.1 半导体的定义和分类

1.1.1 半导体的定义

1.1.2 半导体的分类

1.1.3 半导体的应用

1.2 半导体设备行业概述

1.2.1 行业概念界定

1.2.2 行业主要分类

第二章 2016-2020年中国半导体设备行业发展环境PEST分析

2.1 政策环境（Political）

2.1.1 半导体设备政策汇总

2.1.2 半导体制造利好政策

2.1.3 集成电路企业税收优惠

2.1.4 集成电路产业政策扶持

2.1.5 产业投资基金的支持

2.2 经济环境（Economic）

- 2.2.1 宏观经济发展概况
- 2.2.2 工业经济运行情况
- 2.2.3 经济转型升级发展
- 2.2.4 未来经济发展展望
- 2.3 社会环境 (social)
- 2.3.1 电子信息产业增速
- 2.3.2 电子信息设备规模
- 2.3.3 研发经费投入增长
- 2.3.4 科技人才队伍壮大
- 2.4 技术环境 (Technological)
- 2.4.1 企业研发投入
- 2.4.2 技术迭代历程
- 2.4.3 企业专利状况

第三章 2016-2020年半导体产业链发展状况

- 3.1 半导体产业链分析
 - 3.1.1 半导体产业链结构
 - 3.1.2 半导体产业链流程
 - 3.1.3 半导体产业链转移
- 3.2 2016-2020年全球半导体市场总体分析
 - 3.2.1 市场销售规模
 - 3.2.2 行业产品结构
 - 3.2.3 区域市场格局
 - 3.2.4 产业研发投入
 - 3.2.5 市场竞争状况
 - 3.2.6 企业支出状况
 - 3.2.7 产业发展前景
- 3.3 2016-2020年中国半导体市场运行状况
 - 3.3.1 产业发展历程
 - 3.3.2 产业销售规模
 - 3.3.3 市场规模现状
 - 3.3.4 产业区域分布

- 3.3.5 市场机会分析
- 3.4 2016-2020年中国IC设计行业发展分析
 - 3.4.1 行业发展历程
 - 3.4.2 市场发展规模
 - 3.4.3 企业发展状况
 - 3.4.4 产业地域分布
 - 3.4.5 专利申请情况
 - 3.4.6 资本市场表现
 - 3.4.7 行业面临挑战
- 3.5 2016-2020年中国IC制造行业发展分析
 - 3.5.1 制造工艺分析
 - 3.5.2 晶圆加工技术
 - 3.5.3 市场发展规模
 - 3.5.4 企业排名状况
 - 3.5.5 行业发展措施
- 3.6 2016-2020年中国IC封装测试行业发展分析
 - 3.6.1 封装基本介绍
 - 3.6.2 封装技术趋势
 - 3.6.3 芯片测试原理
 - 3.6.4 市场发展规模
 - 3.6.5 芯片测试分类
 - 3.6.6 企业排名状况
 - 3.6.7 技术发展趋势

第四章 2016-2020年半导体设备行业发展综合分析

- 4.1 2016-2020年全球半导体设备市场发展形势
 - 4.1.1 市场销售规模
 - 4.1.2 市场结构分析
 - 4.1.3 市场区域格局
 - 4.1.4 重点厂商介绍
 - 4.1.5 厂商竞争格局
- 4.2 2016-2020年中国半导体设备市场发展现状

- 4.2.1 市场销售规模
- 4.2.2 市场需求分析
- 4.2.3 企业竞争态势
- 4.2.4 企业产品布局
- 4.2.5 市场国产化率
- 4.2.6 行业发展成就
- 4.3 半导体产业核心设备——晶圆制造设备市场运行分析
 - 4.3.1 设备基本概述
 - 4.3.2 核心环节分析
 - 4.3.3 主要厂商介绍
 - 4.3.4 厂商竞争格局
 - 4.3.5 市场发展规模
- 4.4 半导体产业核心设备——晶圆加工设备市场运行分析
 - 4.4.1 设备基本概述
 - 4.4.2 市场发展规模
 - 4.4.3 市场价值构成
 - 4.4.4 市场竞争格局
- 4.5 半导体设备行业财务状况分析
 - 4.5.1 经营状况分析
 - 4.5.2 盈利能力分析
 - 4.5.3 营运能力分析
 - 4.5.4 成长能力分析
 - 4.5.5 现金流量分析

第五章 2016-2020年半导体光刻设备市场发展分析

- 5.1 半导体光刻环节基本概述
 - 5.1.1 光刻工艺重要性
 - 5.1.2 光刻工艺的原理
 - 5.1.3 光刻工艺的流程
- 5.2 半导体光刻技术发展分析
 - 5.2.1 光刻技术原理
 - 5.2.2 光刻技术历程

- 5.2.3 光学光刻技术
- 5.2.4 EUV光刻技术
- 5.2.5 X射线光刻技术
- 5.2.6 纳米压印光刻技术
- 5.3 2016-2020年光刻机市场发展综述
 - 5.3.1 光刻机工作原理
 - 5.3.2 光刻机发展历程
 - 5.3.3 光刻机产业链条
 - 5.3.4 光刻机市场规模
 - 5.3.5 光刻机竞争格局
 - 5.3.6 光刻机技术差距
- 5.4 光刻设备核心产品——EUV光刻机市场状况
 - 5.4.1 EUV光刻机基本介绍
 - 5.4.2 典型企业经营状况
 - 5.4.3 EUV光刻机需求企业
 - 5.4.4 EUV光刻机研发分析

第六章 2016-2020年半导体刻蚀设备市场发展分析

- 6.1 半导体刻蚀环节基本概述
 - 6.1.1 刻蚀工艺介绍
 - 6.1.2 刻蚀工艺分类
 - 6.1.3 刻蚀工艺参数
- 6.2 干法刻蚀工艺发展优势分析
 - 6.2.1 干法刻蚀优点分析
 - 6.2.2 干法刻蚀应用分类
 - 6.2.3 干法刻蚀技术演进
- 6.3 2016-2020年全球半导体刻蚀设备市场发展状况
 - 6.3.1 市场发展规模
 - 6.3.2 市场竞争格局
 - 6.3.3 设备研发支出
- 6.4 2016-2020年中国半导体刻蚀设备市场发展状况
 - 6.4.1 市场发展规模

- 6.4.2 企业发展现状
- 6.4.3 市场需求状况
- 6.4.4 市场空间测算
- 6.4.5 市场发展机遇

第七章 2016-2020年半导体清洗设备市场发展分析

- 7.1 半导体清洗环节基本概述
 - 7.1.1 清洗环节的重要性
 - 7.1.2 清洗工艺类型比较
 - 7.1.3 清洗设备技术原理
 - 7.1.4 清洗设备主要类型
 - 7.1.5 清洗设备主要部件
- 7.2 2016-2020年半导体清洗设备市场发展状况
 - 7.2.1 市场发展规模
 - 7.2.2 市场竞争格局
 - 7.2.3 市场发展机遇
 - 7.2.4 市场发展趋势
- 7.3 半导体清洗机领先企业布局状况
 - 7.3.1 迪恩士公司
 - 7.3.2 盛美半导体
 - 7.3.3 至纯科技公司
 - 7.3.4 国产化布局

第八章 2016-2020年半导体测试设备市场发展分析

- 8.1 半导体测试环节基本概述
 - 8.1.1 测试流程介绍
 - 8.1.2 前道工艺检测
 - 8.1.3 中后道的测试
- 8.2 2016-2020年半导体测试设备市场发展状况
 - 8.2.1 市场发展规模
 - 8.2.2 市场竞争格局
 - 8.2.3 细分市场结构

- 8.2.4 设备制造厂商
- 8.2.5 主要产品介绍
- 8.3 半导体测试设备重点企业发展启示
 - 8.3.1 泰瑞达
 - 8.3.2 爱德万
- 8.4 半导体测试核心设备发展分析
 - 8.4.1 测试机
 - 8.4.2 分选机
 - 8.4.3 探针台

第九章 2016-2020年半导体产业其他设备市场发展分析

- 9.1 单晶炉设备
 - 9.1.1 设备基本概述
 - 9.1.2 市场发展现状
 - 9.1.3 企业竞争格局
 - 9.1.4 市场空间测算
- 9.2 氧化/扩散设备
 - 9.2.1 设备基本概述
 - 9.2.2 市场发展现状
 - 9.2.3 企业竞争格局
 - 9.2.4 核心产品介绍
- 9.3 薄膜沉积设备
 - 9.3.1 设备基本概述
 - 9.3.2 市场发展现状
 - 9.3.3 企业竞争格局
 - 9.3.4 市场前景展望
- 9.4 化学机械抛光设备
 - 9.4.1 设备基本概述
 - 9.4.2 市场发展规模
 - 9.4.3 市场竞争格局
 - 9.4.4 主要企业分析

第十章 2016-2020年国外半导体设备重点企业经营状况

10.1 应用材料 (Applied Materials, Inc.)

10.1.1 企业发展概况

10.1.2 企业发展历程

10.1.3 企业经营状况

10.1.4 企业核心产品

10.1.5 企业业务布局

10.1.6 企业发展前景

10.2 泛林集团 (Lam Research Corp.)

10.2.1 企业发展概况

10.2.2 企业经营状况

10.2.3 企业核心产品

10.2.4 企业发展前景

10.3 阿斯麦 (ASML Holding NV)

10.3.1 企业发展概况

10.3.2 企业发展历程

10.3.3 企业经营状况

10.3.4 企业核心产品

10.3.5 企业发展前景

10.4 东京电子 (Tokyo Electron, TEL)

10.4.1 企业发展概况

10.4.2 企业经营状况

10.4.3 企业核心产品

10.4.4 企业发展前景

第十一章 国内半导体设备重点企业经营状况分析

11.1 浙江晶盛机电股份有限公司

11.1.1 企业发展概况

11.1.2 经营效益分析

11.1.3 业务经营分析

11.1.4 财务状况分析

11.1.5 核心竞争力分析

11.2 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

11.2.1 企业发展概况

11.2.2 经营效益分析

11.2.3 业务经营分析

11.2.4 财务状况分析

11.2.5 核心竞争力分析

11.3 中微半导体设备（上海）股份有限公司

11.3.1 企业发展概况

11.3.2 经营效益分析

11.3.3 业务经营分析

11.3.4 财务状况分析

11.3.5 核心竞争力分析

11.4 北方华创科技集团股份有限公司

11.4.1 企业发展概况

11.4.2 经营效益分析

11.4.3 业务经营分析

11.4.4 财务状况分析

11.4.5 核心竞争力分析

11.5 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

11.5.1 企业发展概况

11.5.2 经营效益分析

11.5.3 业务经营分析

11.5.4 财务状况分析

11.5.5 核心竞争力分析

11.6 北京华峰测控技术股份有限公司

11.6.1 企业发展概况

11.6.2 经营效益分析

11.6.3 业务经营分析

11.6.4 财务状况分析

11.6.5 核心竞争力分析

11.7 中电科电子

11.7.1 企业发展概况

- 11.7.2 企业核心产品
- 11.7.3 企业参与项目
- 11.7.4 产品研发动态
- 11.7.5 企业发展前景
- 11.8 上海微电子
- 11.8.1 企业发展概况
- 11.8.2 企业发展历程
- 11.8.3 企业参与项目
- 11.8.4 企业创新能力
- 11.8.5 企业发展地位

第十二章 半导体设备行业投资价值分析

- 12.1 半导体设备企业并购市场发展状况
 - 12.1.1 企业并购历史回顾
 - 12.1.2 行业并购特征分析
 - 12.1.3 企业并购动机归因
 - 12.1.4 国内企业并购动态
- 12.2 中国半导体设备市场投资机遇分析
 - 12.2.1 整体投资机遇分析
 - 12.2.2 建厂加速拉动需求
 - 12.2.3 产业政策扶持发展
- 12.3 半导体设备行业投资机会点分析
 - 12.3.1 薄膜工艺设备
 - 12.3.2 刻蚀工艺设备
 - 12.3.3 光刻工艺设备
 - 12.3.4 清洗工艺设备
- 12.4 半导体设备行业投资壁垒分析
 - 12.4.1 技术壁垒分析
 - 12.4.2 客户验证壁垒
 - 12.4.3 竞争壁垒分析
 - 12.4.4 资金壁垒分析
- 12.5 半导体设备行业投资风险分析

- 12.5.1 经营风险分析
- 12.5.2 行业风险分析
- 12.5.3 宏观环境风险
- 12.5.4 知识产权风险
- 12.5.5 人才资源风险
- 12.5.6 技术研发风险
- 12.6 半导体设备投资价值评估及建议
- 12.6.1 投资价值综合评估
- 12.6.2 行业投资特点分析
- 12.6.3 行业投资策略建议

第十三章 中国行业标杆企业项目投资建设案例深度解析

- 13.1 半导体湿法设备制造项目
- 13.1.1 项目基本概述
- 13.1.2 资金需求测算
- 13.1.3 建设内容规划
- 13.1.4 经济效益分析
- 13.1.5 项目基本概述
- 13.1.6 资金需求测算
- 13.1.7 实施进度安排
- 13.1.8 经济效益分析
- 13.2 光刻机产业化项目
- 13.2.1 项目基本概述
- 13.2.2 资金需求测算
- 13.2.3 建设内容规划
- 13.2.4 经济效益分析
- 13.3 半导体设备产业化基地建设项目
- 13.3.1 项目基本概述
- 13.3.2 资金需求测算
- 13.3.3 项目进度安排
- 13.3.4 项目投资价值

第十四章 2022-2028年中国半导体设备行业发展趋势及预测分析

14.1 中国半导体产业未来发展趋势（ ）

14.1.1 技术发展利好

14.1.2 自主创新发展

14.1.3 产业地位提升

14.1.4 市场应用前景

14.2 中国半导体设备行业发展前景展望

14.2.1 政策支持发展

14.2.2 行业发展机遇

14.2.3 市场应用需求

14.2.4 行业发展前景

14.3 2022-2028年中国半导体设备行业预测分析

14.3.1 2022-2028年中国半导体设备行业影响因素分析

14.3.2 2022-2028年中国大陆半导体设备销售规模预测

图表目录

图表1 半导体分类结构图

图表2 半导体分类

图表3 半导体分类及应用

图表4 半导体设备构成

图表5 IC芯片制造核心工艺主要设备全景图

图表6 中国半导体设备行业相关政策汇总

图表7 《中国制造2025》半导体产业政策目标与政策支持

图表8 2016-2020年IC产业政策目标与发展重点

图表9 一期大基金投资各领域份额占比

图表10 国家集成电路产业基金二期出资方（一）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/U72719D7ZG.html>